



连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SD 卡连接器



兼容卡: 微型安全数字

位数: 8

中心线（间距）: 1.1 mm [.04 in]

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
兼容卡	微型安全数字

结构特性

行数	1
位数	8
PCB 安装方向	直角

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子底板材料	镍
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	1.1 mm[.04 in]

尺寸

PCB 的外形高度	2.45 mm[.09 in]
-----------	-----------------

操作/应用



装配工艺特点	压紧
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [SIM 连接器](#)



SC 连接器(2)

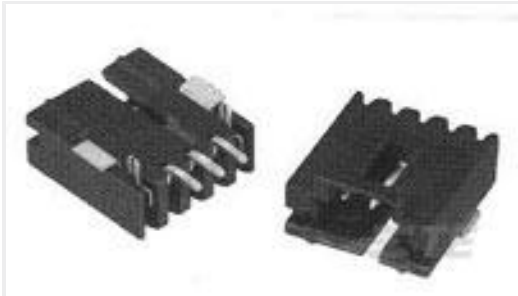


SIM 卡连接器(9)

客户还购买了



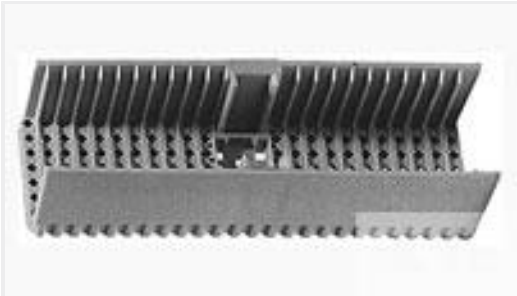
TE 产品编号50935-6
SOCKET,MIN-SPR AU-AU SER-1



TE 产品编号5-147278-4
05 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL



TE 产品编号1-440054-3
2.0MM,HDR,13POS,VERTICAL



TE 产品编号646482-2
2MM H.M.,B-22 SHROUD 3.9MM



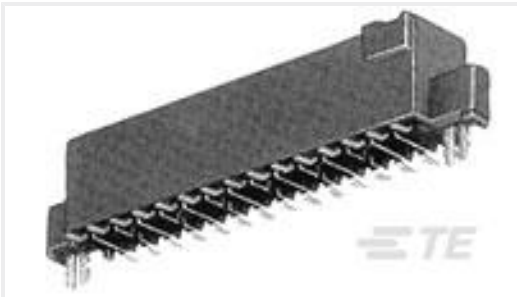
TE 产品编号1903977-1
SLIM UPM 4POS. R/A HDR ASSEMBL



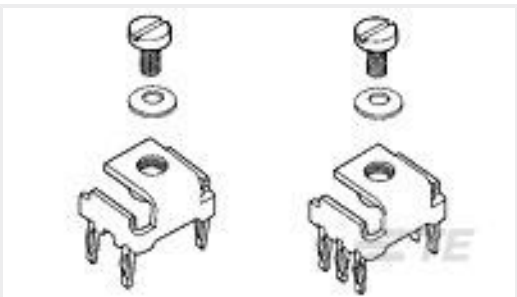
TE 产品编号5120658-1
Z-PACK HS3 HDR ASY 10R 100P



TE 产品编号1-5316559-1
.6FHP04H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes



TE 产品编号1-104652-0
100 50/50 GRID DRST SFMNT RCPT



TE 产品编号216906-1
.250 POWER TERM.A.P

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2199003-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2199003-2_D.3d_igs.zip

2199003-2

Micro SIM-SD dual conn 2.5H push-pull



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2199003-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。